

中国半导体行业协会集成电路设计分会

中半协设分函〔2021〕4号

关于举办“中国集成电路设计业 2021 年会 暨无锡集成电路产业创新发展高峰论坛”的通知

各有关单位：

集成电路产业是电子信息产业的核心，是支撑国家经济社会发展的战略性、基础性、先导性产业，也是新基建的基石。当前我国集成电路产业发展处于关键时期，国家高度重视集成电路产业的发展并出台了一系列政策。随着我国集成电路产业自主创新发展，其市场规模、企业竞争力等不断提升，中国已经成为全球规模最大、增速最快的集成电路市场。当前全球集成电路产业已经进入到发展的重大转型期和变革期，集成电路设计业作为产业龙头，作为技术和产品创新的重要环节，在产业发展中承担着重要责任，同时也是半导体产业实现自主可控的关键。

在我国集成电路设计产业的发展中，中国集成电路设计业年会一直发挥着推动产业集聚、对接产业资源、掌握行业趋势的重要作用。多年来，年会的主题与会议主办地电子信息产业发展实际相结合，推动了各主办地的相关产业与国家集成电路产业同步发展。为此，特定于 2021 年 11 月 11 日-12 日在无锡举办“中国集成电路设计业 2021 年会暨无锡集成电路产业创新发展高峰论坛”。

本次年会以“**聚力赋能，融合创新**”为主题，将深入探讨集成电路产业，特别是集成电路设计业面临的机遇和挑战；提升创新能力，增强中国集成电路产业链的综合能力，以满足市场的需求和提高国际竞争力。大会将为集成电路产业链各个环节的企业营造一个交流与合作的平台，为集成电路设计企业构筑在技术、市场、应用、投资等领域交流合作的平台。

现将本届年会的有关事项通知如下：

- 一、指导单位：江苏省工业和信息化厅
无锡市人民政府
中国半导体行业协会

- 二、主办单位：中国半导体行业协会集成电路设计分会
“核高基”国家科技重大专项总体专家组
中国集成电路设计创新联盟
国家集成电路设计（无锡）产业化基地
- 三、支持单位：无锡市工业和信息化局
无锡市新吴区人民政府
- 四、承办单位：中国半导体行业协会集成电路设计分会
江苏省半导体行业协会
无锡市半导体行业协会
江苏省产业技术研究院智能集成电路设计技术研究所
上海芯媒会务服务有限公司
上海亚讯商务咨询有限公司
- 五、协办单位：中国通信学会通信专用集成电路委员会
《中国集成电路》杂志社
- 六、报到时间：2021年11月10日（周三）
会议时间：2021年11月11日-12日
- 七、报到地点：无锡君来世尊酒店（地址：无锡市太湖新城和风路111号）
会议地点：无锡太湖国际博览中心（地址：无锡市太湖新城清舒道88号）
- 八、会议内容
1. 主题报告
 - （1）我国集成电路设计业现状与发展报告
 - （2）统筹科技资源，实现创新发展报告
 - （3）全球集成电路技术与产业发展趋势报告
 2. 专题研讨会
 - 整机系统与IC设计
 - IC设计与EDA软件
 - Foundry与工艺技术
 - IC封装与测试
 - IP与IC设计服务

- 资本与创业
 - 无锡集成电路创新创业论坛
3. 中国集成电路设计产业展览

九、参会人员

相关部委和地方领导、国内外有关专家、各地方基地和行业协会代表、国内外集成电路设计企业及 IP 服务厂商、EDA 厂商、Foundry 厂商、封装测试厂商、系统厂商、风险投资公司、集成电路产业园区和有关媒体代表等。

十、联系方法

联系人：胡芑

电话：18917192814，邮箱：shirleyhp@cicmag.com

联系人：王媛媛

电话：18600095161，邮箱：wangyy@csia-iccad.net.cn

请年会承办单位认真做好会议的各项组织和筹备工作，确保会议圆满成功。

附件：参会回执表



中国集成电路设计业 2021 年会 暨无锡集成电路产业创新发展高峰论坛 参会回执表

单位名称						
地址					邮编	
主营业务	<input type="checkbox"/> IC 设计 <input type="checkbox"/> EDA <input type="checkbox"/> IP <input type="checkbox"/> IC 设计服务 <input type="checkbox"/> Foundry <input type="checkbox"/> 封装 <input type="checkbox"/> 测试 <input type="checkbox"/> 政府和协会 <input type="checkbox"/> 大学和研究院所 <input type="checkbox"/> ICC 和园区 <input type="checkbox"/> 其他				参会总人数	共 人
参会代表	性 别	职 务	邮 箱	电 话	手 机	会 务 费 类 别
						A B C D
						A B C D
						A B C D
会议 联系人	电话/手机		E-mail			
<p>我单位希望参加本次年会，请预留名额并寄发请柬。</p> <p>■会务费：<无锡君来世尊酒店，含会议住宿、用餐、茶点、资料等></p> <p><input type="checkbox"/> A 类：2000 元人民币/人（不含住宿和考察）</p> <p><input type="checkbox"/> B 类：2400 元人民币/人（不含住宿，含考察）</p> <p><input type="checkbox"/> C 类：3240 元人民币/人（包含酒店双人间一个床位三晚住宿，合住，含考察）</p> <p><input type="checkbox"/> D 类：4080 元人民币/人（包含酒店一间大或双床房三晚住宿，单住，含考察）</p> <p>注：1、入住日期：11 月 10 日；退房日期：11 月 13 日。房费：560 元人民币/晚/间（含单或双早）。 2、由于酒店房间不能预留，组委会仅对提前支付 C 类或 D 类会务费的参会人员保留房间，且依照汇款顺序，先到先得。如有其他需要，请提前与组委会联系并登记。</p> <p style="text-align: right;">合计金额：人民币_____ 元</p>						
<p>■银行转帐：</p> <p>户 名：上海芯媒会务服务有限公司</p> <p>开户行：上海银行浦西分行</p> <p>帐 号：31691303001832394</p>						
负责人签字：						2021 年 月 日

此表复印有效，请将此表格连同汇款凭证一起通过邮件回复至年会筹备组，以便会务组安排好各项工作。我们真诚期待您的参与！